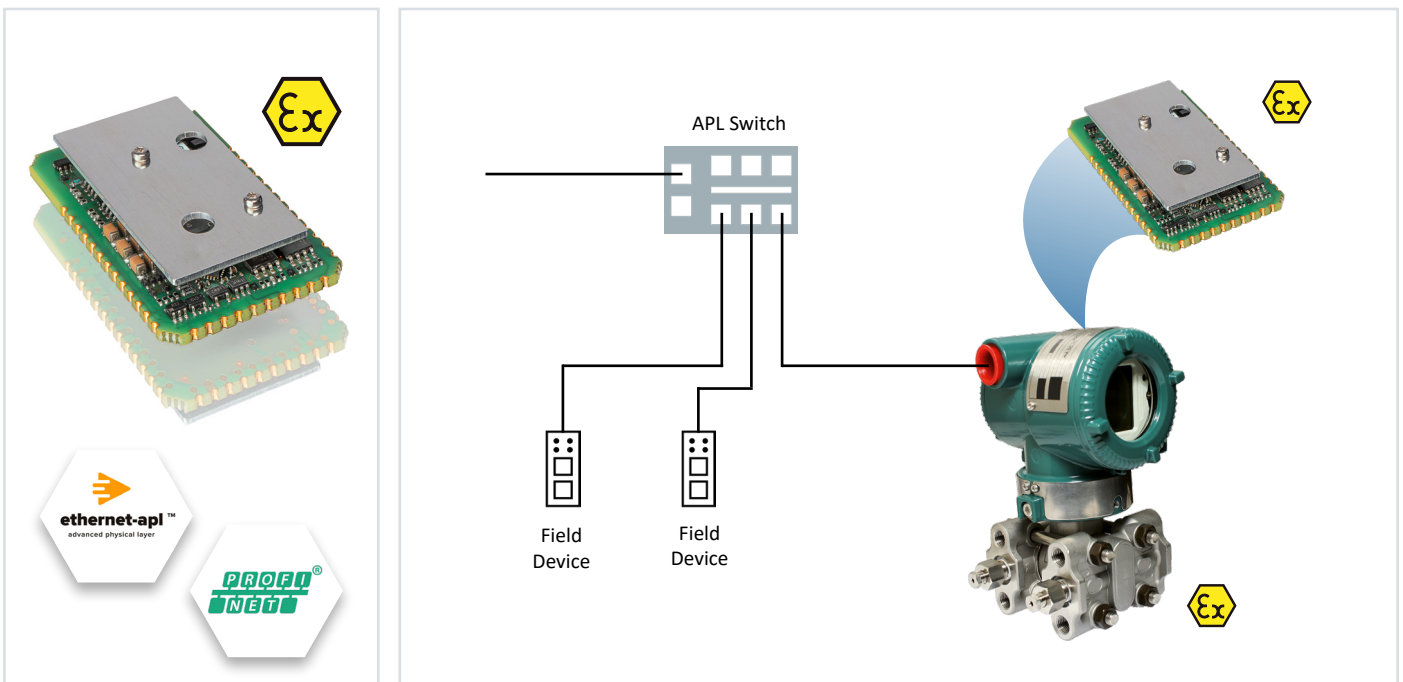


commModule APL (vorläufig)

Kernelektronik für APL-Feldgeräte

- **Schnelle und kostengünstige Ethernet-APL-Implementierung für Prozessautomatisierungsgeräte**
- **PROFINET-Protokollsoftware nach PA-Profil 4.02 bereits onboard**
- **Ermöglicht eigensichere Hardware-Designs für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen**
- **Einfache Integration in HART- und Modbus-Geräte**



Schnelle und kostengünstige Umsetzung

- Geringer Platzbedarf für den Einsatz in den meisten Prozessanlagen
- Keine aufwändige Hardwareentwicklung erforderlich
- Keine Stack-Portierung, keine Anwendungsprogrammierung
- Nur einseitig platzierte Komponenten zur automatischen Montage auf der Hauptplatine

PROFINET-Protokollsoftware nach PA-Profil 4.02 bereits onboard

- Die Implementierung folgt den neuesten APL- und PI-Spezifikationen
- Eine Laufzeitlizenz für die Software ist bereits enthalten

Für eigensichere Hardware-Designs entwickelt

- Vergossene und unvergossene Ausführung für optimiertes Ex-Design
- ATEX- und IECEx-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen

Einfache Integration in HART- und Modbus-Geräte

- Skriptgesteuerte Abbildung der Funktionsblockanwendung auf gerätespezifische HART- oder Modbus-Befehle
- Keine Notwendigkeit für C-Programmierung
- commScripter-Tool prüft Skript und erstellt Zuordnungstabelle
- Serienmäßige commModule werden durch Herunterladen einer Zuordnungstabelle angepasst

commModule APL

Technische Daten

Hardware	Prozessor	Renesas RX64M
	RAM	2,5 MByte
	Flash	4 MB (auf dem Chip)
	nichtflüchtiger RAM	On-Chip zur dauerhaften Speicherung von Parametern
	Anschlüsse	Löt pads am Rand der Platine
	Stromverbrauch	50 mA
	Stromversorgung zum Gerät	3,2 V (max. 70 mW) und 6,2 V (max. 90 mW)
	Betriebstemperatur	-40 °C ... +80 °C
	Lagertemperatur	-40 °C ... +125 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	10 % ... 90% nicht kondensierend
	Montage	Löten (automatische Bestückung bei unvergossener Version möglich)
	Gewicht	15 g (vergossen), 8 g (unvergossen)
	Abmessungen	32,0 x 54,7 x 8,0 mm
Schnittstellen	Feldbusschnittstelle	PROFINET über APL mit PA-Profil 4.02
	Schnittstelle zum Anwendungsgerät	für reguläre commKit-Firmware: UART, für benutzerspezifische Firmware: UART, I2C, SPI
	Protokoll zum Anwendungsgerät	HART, Modbus (bald verfügbar) oder benutzerspezifisch
Zertifikate	ATEX	In Vorbereitung
	IECEX	In Vorbereitung

Lieferumfang

Hardware	Vorläufige technische Muster des commModule APL auf Anfrage erhältlich Produktionsgeräte im Tray (versiegelte Trockenpackung) noch in diesem Jahr erhältlich
Firmware	PROFINET-Geräte-Stack, Mapping-Anwendung
Dokumentation	Hardware-Handbuch

Bestellnummern

EIA-AS-022430	commModule APL vergossen, Muster
EIA-AS-022450	commModule APL unvergossen, Muster

Ergänzende Produkte und Dienstleistungen

EVA-MA-022240	commModule Evaluation Kit (commModule APL im Gehäuse mit Steckern)
DXA-KL-020621	Renesas E2 Lite Flasher
LDA-AM-022755	commScripter, Einzelplatz-Entwicklerlizenz PROFINET zu HART
LDA-AM-022756	commScripter, Einzelplatz-Entwicklerlizenz PROFINET zu Modbus
HUA-AA-001012	USB-Hardlock für commScripter-Lizenzen
SIA-AY-022471	commScripter APL-Workshop (pro Tag)
SIA-KL-020100	Integration-Support (pro Stunde)

Ihr lokaler Kontakt zu Softing:

<https://industrial.softing.com>

optimize!
softing